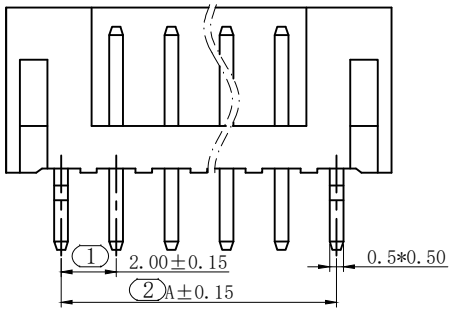
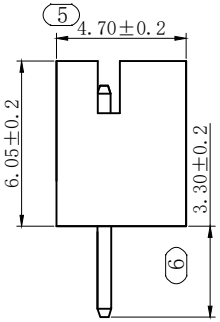
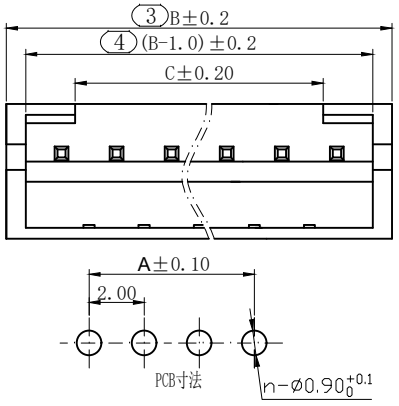
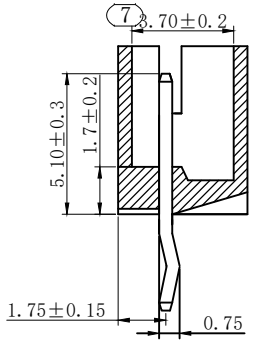
REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	新版发行	230509





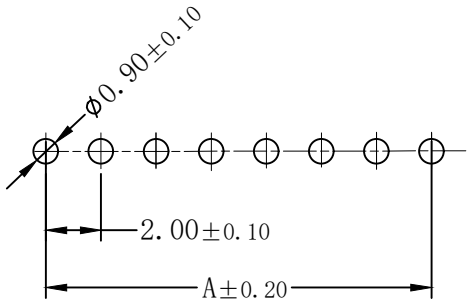




技术要求：

1、塑件材料：PA66（UL-94V-0）
2、接触件：黄铜镀锡
3、接触电阻：≤10mΩ
4、绝缘电阻：≥1000MΩ
5、额定电压：250V AC DC
6、额定电流：2.0A AC DC
7、耐压：能承受1000V AC/Minute
8、工作温度：-25° ~~+85°
9、可焊性试验：浸锡面积≥95%温度$235^{+5^\circ}_{-0}$,时间2.5±0.5秒
10、铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
02	2.00	6.00
03	4.00	8.00
04	6.00	10.00
05	8.00	12.00
06	10.00	14.00
07	12.00	16.00
08	14.00	18.00
09	16.00	20.00
10	18.00	22.00
11	20.00	24.00
12	22.00	26.00
13	24.00	28.00
...	...	...
20	38.00	44.00



SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

序号	名 称	材 料	数 量	附 注
2	端子 Contact	黄铜	n×1	电镀(镀): 整个表面镀底镍30u"MIN,焊锡镀 80u"MIN..
1	基座 Wafer	PA66(UL94V-0)	1	白色

GENERAL TOLERANCES			DRAWN BY	深圳市宝通成电子有限公司		
0.X ±0.25	X.° ±3°		CHK. BY			
0.XX ±0.12			APRV. BY	SHEET	PROD. NAME	PH 2.0 直针 n*P
0.XXX ±0.05	X.X° ±0.5°			1 OF 1	PART NO.	BTC-PH2.0-NPZZ-MS
UNIT	SIZE	SCALE	DRAWING NO.	TITLE		
MM	A4	1:1				

借用登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期